

Press Release

「POWTEX®2025 国際粉体工業展大阪」 出展のお知らせ

シコーの技術を通して“感動の共有”を。粉体技術が社会にもたらす変革を共に目指します。



引用元：<https://www.powtex.com/osaka/>

シコー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表：白石忠臣、以下シコー）は、2025年10月15日（水）～17日（金）にインテックス大阪にて開催される「POWTEX®2025 国際粉体工業展大阪」に出展することをお知らせいたします。

今回の「POWTEX®2025 国際粉体工業展大阪」は、粉体工業展としては通算で45回目の開催となり、「未来をつくるPX（Powder-technology Transformation）—粉体技術で描く未来社会のデザイン」をテーマとしています。

この度シコーは、2度目の粉体工業展への出展となります。今回の「POWTEX®2025 国際粉体工業展大阪」においては、シコーのビジョンである“包装で創るストレスフリーな世界～つかいやすく、かたづけやすく、つくりやすい～”をコンセプトに我々の持つ技術力を多くの来場者に伝えることで“感動の共有”を提供してまいりたいと考えております。

特に粉漏れ、荷崩れ防止技術、クリーンルームでも利用可能な両底バックインバック技術、物流問題の解決技術など、シコー独自の技術は幅広い課題やニーズに対しても対応可能になっております。

Press Release

是非、展示会に足を運んでいただいた際にはシコーのブースにお越しいただき、「感動の共有」を体験していただければ幸いです。

【主な展示内容】

〈ブース番号：4-N07〉

・穴あけ加工とナノパーフォレーション

シコー独自の微細な穴あけ加工で紙袋本体からの脱気が可能となり、「粉漏れ防止」「作業効率向上」「荷崩れ防止」などが期待できます。



・両底バッグインバッグ

両底袋のポリ内袋を取り出してクリーンルームで利用可能となる「クリーンルーム対応の両底袋」です。



Press Release

・物流問題を解決する両底袋・片底袋

底幅を大きくすることでパレットにあわせた寸法変更を実現しており、「積載効率の改善」が期待できます。



・粉漏れ問題を解決するインナーパッチ・ダブルパッチ

粉漏れ防止で作業現場やトラックの荷台の汚れを防止でき、「作業効率向上」「清掃コスト削減」が期待できます。



Press Release

・マイクロパーフォレーションバッグ

ポリ内袋入りの紙袋で充填後の脱気が可能となり「荷滑り防止」が期待できます。



【代表取締役社長 白石忠臣コメント】

粉体工業展への出展は昨年の東京開催に続いて、今回の大阪開催で二度目となります。昨年の粉体工業展では、我々が思っている以上に多くの紙袋に関わる課題をお持ちの企業様が多くいることを知る貴重な場となりました。今年の粉体工業展大阪でも弊社ビジョンである「包装で創るストレスフリーな世界～つかいやすく、かたづけやすく、つくりやすい～」という考えのもと、数多くの課題解決できる商品を用意致しました。是非、展示会場に足を運んで頂き、商品を手にとっていただければ幸いです。

【シコー株式会社とは】

食品、化学品をはじめとする産業用包装資材を製造販売するシコー株式会社は「包装で創るストレスフリーな世界～つかいやすく、かたづけやすく、つくりやすい～」をビジョンに、包装に関係する製品を提供しています。

代表取締役社長 白石忠臣

住所：(本社) 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-1500 大阪駅前第三ビル15階

- ・シコーコーポレートサイト <https://www.siko.co.jp/>
- ・シコラサイト <https://www.siko.co.jp/entrance-sikora/>
- ・ソリューションサイト <https://www.siko-solution.com/>

【報道機関からのお問い合わせ】

info@siko.co.jp